

와이엠티 (251370)

파멸적 상승에는 이유가 있다

투자의견

NR

목표주가

-원

현재주가

15,320 원(9/18)

시가총액

250(십억원)

IT/전기전자 이주형_02)368-6190_jhlee2207@eugenefn.com

- 최종표면처리 및 화학동도금 등 PCB 케미컬 및 도금 전문 업체. 기존 FPCB/PKG 위주의 사업 포트폴리오에서 HDI/FC-BGA/MLB 등 성장성이 높은 시장으로 확장하는 국면의 초입
- 2분기 실적은 매출액 351억원(YoY +0.8%), 영업이익 40.2억원(YoY +336%, OPM 11.5%)을 기록. 본사 인적비용 쇄신을 통한 손익구조 개선과 중국 법인의 AI 가속기 PCB용 최종표면처리 케미컬 매출 인식에 따라 2분기 전사 영업이익률은 전기비 7.1%p 상승
- AI 가속기의 성능이 지속적으로 고도화되는 상황 속, 기존 주류를 차지하고 있던 ENIG 공정에서 ENEPIG 공정으로의 전환 진행중. 와이엠티의 ENEPIG 금도금 케미컬 제품은 중국 기판 고객과 북미 고객 모두의 승인을 득하고 2분기부터 업계 최초로 채택, 납품을 시작. 금도금 공정 내 독과점에 가까운 점유율을 보유하고 있는 일본 우에무라를 제치고 선제적으로 레퍼런스를 확보했다는 점에서 향후 확장성 긍정적
- TGV Via Fill 케미컬과 도금 공정에서의 기술 경쟁력 역시 독보적. X-Bridge 방식의 Via Fill을 통해 낮은 Void 비율과 높은 양산성을 확보. 주요 기판 고객의 유리기판 양산 진입은 2027년으로 예상되나, 동사와 같은 영세업체의 경우 대량 양산 진입 이전의 유사 샘플 공급 확대에도 괄목할 만한 매출 및 이익 규모 성장이 가능할 전망
- 이외에도 T-Glass 적용 확대에 따른 대만계 PKG회사향 제품 포트폴리오 확대의 기회, Nanotus 기술을 기반으로 중국 동박 업체와 협업을 통한 하이엔드 동박 시장 진출 등 다수의 모멘텀이 상존. 최근 5영업일간 다소 가파른 주가 상승을 보였으나, 중장기적으로 꾸준한 실적 개선이 동반될 것으로 예상. 2025년 연간 실적은 매출액 1,401억원(YoY +1.8%), 영업이익 104억원(YoY +189%, OPM 7.4%)예상

주가(원,9/18)	15,320
시가총액(십억원)	250
발행주식수	16,314천주
52주 최고가	15,800원
최저가	7,790원
52주 일간 Beta	1.32
60일 일평균거래대금	7억원
외국인 지분율	2.5%
배당수익률(2025F)	0.0%
주주구성	
전성욱(외 7인)	39.5%
자사주	2.2%

주가상승	1M	6M	12M
상대기준	41.3%	29.3%	53.3%
절대기준	48.7%	44.3%	70.2%
(원, 십억원)	현재	직전	변동
투자의견	NR	-	-
목표주가	-	-	-
영업이익(25)	-	-	-
영업이익(26)	-	-	-

12월 결산(십억원)	2021A	2022A	2023A	2024A
매출액	126	131	127	137
영업이익	17	3	-3	4
세전손익	16	3	0	-1
당기순이익	14	3	0	-2
EPS(원)	311	-2	-91	-140
증감률(%)	-32	적전	적지	적지
PER(배)	72.8	n/a	n/a	n/a
ROE(%)	9.1	0	-2.3	-2.9
PBR(배)	6.2	3.5	3.6	2.5
EV/EBITDA(배)	14.2	0.7	6.6	4.8

자료: 유진투자증권



I. 기업개요

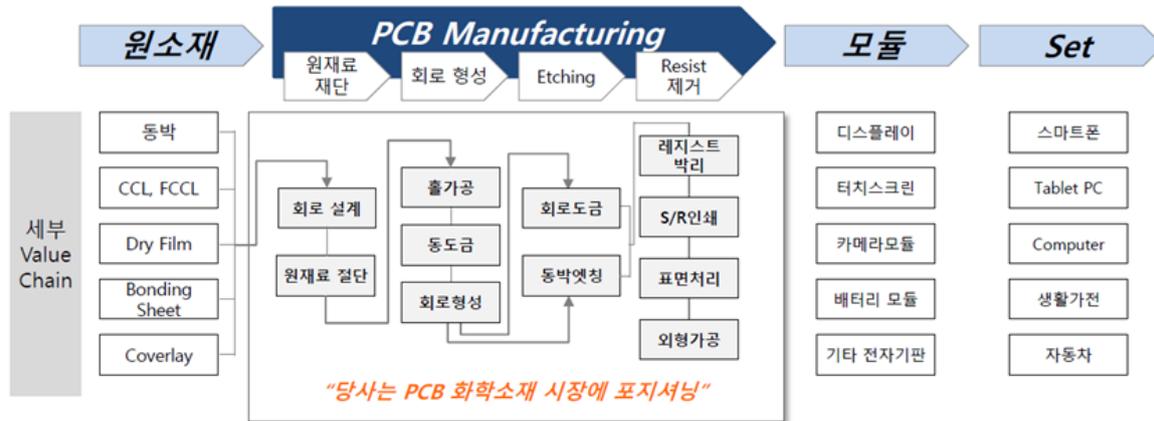
20년 PCB 외길 인생

최종표면처리 및 화학동도금 등 PCB 케미컬 및 도금 분야에 포지셔닝한 기업. 금/동도금 공정약품의 생산과 금/동도금기판의 가공처리, 도금장비 제조 및 판매 사업 등을 영위. 경쟁사는 아토텍(독), 우에무라(일), JCU(일), 듀퐁(미) 등이며, 이들 업체들이 분야별로 독과점을 이루고 있는 구조. 와이엠티는 국내외 FPCB 업체를 시작으로 PKG 썬스까지 제품 포트폴리오를 확장. 1999년 설립 이후 20년 이상의 기간동안 PCB에만 집중, 최근 북미 고객향 AI 서버 보드용 HDI 기판 금도금 약품을 중국 주요 기판 고객사에 납품. 주요 경쟁사인 우에무라보다 앞서 HDI 분야에서 ENEPIG 프로세스에 대한 레퍼런스를 확보. 상대적으로 전방 시장의 규모와 확장성이 낮은 FPCB/PKG 위주의 사업이 HDI로의 확장에 성공. 향후 FC-BGA, MLB 향 케미컬 진입을 시도하는 중.

2024년 연간 실적은 매출액 1,376억원(YoY +8.1%), 영업이익 36억원(YoY 흑전, OPM 2.6%)을 기록. 2023년은 IT 수요 부진과 와이엠티의 극동박 제품인 Nanotus 양산라인 투자 및 인력 총원 등 고정비 증가에 따라 연간 영업이익 적자를 기록했으나, 최근 Nanotus 양산 관련 인력 감축을 통한 손익구조 개선과 베트남 법인의 케미컬 매출 증가, 중국 법인의 표면처리 케미컬 매출 증가에 따라 전사 실적 개선 추세.

2분기 실적은 매출액 351억원(YoY +0.8%), 영업이익 40.2억원(YoY +336%, OPM 11.5%)기록. 1분기 대비 매출액은 약 1.4억원 증가했으나, 본사 인적비용 삭신을 통한 손익구조 개선과 중국 법인의 중국 기판 고객사향 고부가가치 최종표면처리 케미컬 매출 인식에 따라 2분기 전사 영업이익률은 전기비 7.1%p 상승.

도표 1. PCB 산업 밸류체인



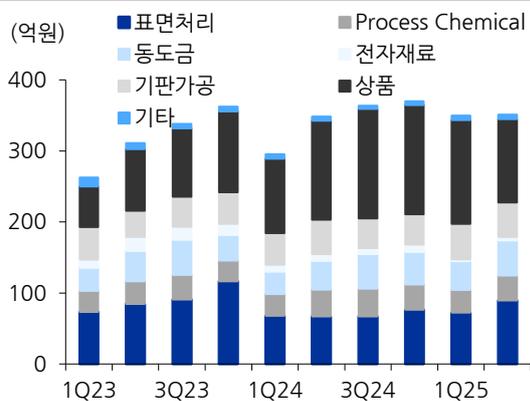
자료: 와이엠티 유진투자증권

도표 2. 와이엠티 고객사 포트폴리오



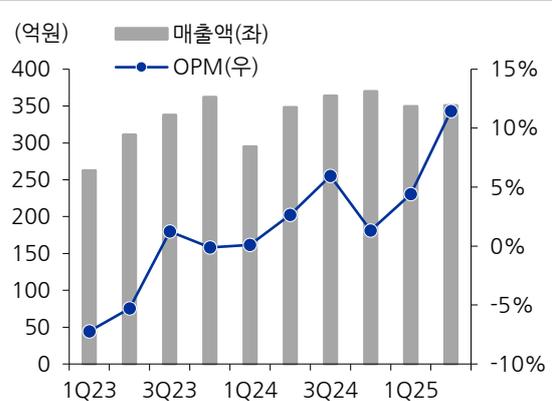
자료: 와이엠티, 유진투자증권

도표 3. 분기별 매출액 추이



자료: 와이엠티, 유진투자증권

도표 4. 분기별 매출 및 영업이익 추이



자료: 와이엠티, 유진투자증권

II. 투자포인트

FPCB 에서 HDI 로, 세트에서 AI 로

2 분기 와이엠티는 중국 현지 법인을 통해 AI 및 HPC 용 첨단 PCB 전문으로 제조하는 중국계 PCB 업체인 ENEPIG 금도금 케미컬 납품을 시작. 해당 고객사는 AI 서버용 HDI PCB 보드를 납품하고 있으며, 와이엠티의 ENEPIG 금도금 케미컬 제품은 엔드 유저인 북미 서버 업체의 승인도 득하였음. 2 분기 중 인식된 관련 매출액은 그 규모가 크지 않으나, 금도금 케미컬 제품의 생산 능력 증대에 필요한 비용과 시간이 적다는 점과 강력한 레퍼런스를 확보한 점을 고려하면 향후 매출액은 빠른 속도로 증가할 가능성이 있음. HDI 제조 공정 내 ENEPIG 금도금 프로세스의 적용은 와이엠티가 최초. 기존 금도금 공정 내 독과점에 가까운 점유율을 보유하고 있는 일본 우에무라(Uyemura)를 제치고 ENEPIG 레퍼런스를 선제적으로 확보했다는 점에서 향후 확장성에 긍정적이라고 평가.

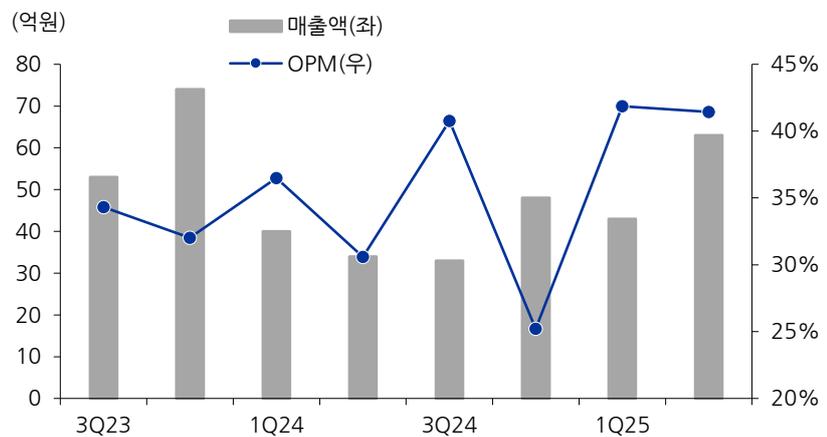
PKG 를 포함한 PCB 보드에서 부품 실장의 신뢰성과 높은 신호 품질, 기계적 내구성을 확보하기 위해서는 금도금이 필수적. 다만, HDI PCB 를 비롯한 대부분의 PCB 보드는 ENIG(무전해 니켈/화학 금 도금, Electroless Nickel/Immersion Gold)공정을 채택. 그러나 랙서버를 구성하는 AI 가속기의 성능이 지속적으로 고도화되는 상황 속, HDI 보드의 L/S(Line and Space)가 미세화되고 있음. 미세 회로 패턴에서는 무전해 방식으로 도금한 니켈층의 표면이 더 얇아지고, 균일성이 중요해짐. 이러한 변화 속에서 기존 주류를 차지하고 있던 ENIG 공정은 Black Pad(화학 금 도금 과정에서 사용되는 인산계의 화학 용액이 니켈층을 과도하게 부식시켜, 니켈 표면이 거르게 변하고 솔더 접합 불량률 유발하는 부분)발생과 관련하여 취약성을 보임. 반면, 와이엠티가 최초로 인증 받은 ENEPIG(무전해 니켈/무전해 팔라듐/화학 금 도금, Electroless Nickel/Electroless Palladium/Immersion Gold)는 무전해 팔라듐 층을 추가로 도금하여 Black Pad 발생을 방지함. 이를 통해 높은 신뢰성을 확보하고 신호 손실 및 불량률을 최소화. 특히 L/S 가 30 마이크로미터 이하로 내려가는 AI 서버용 HDI 제품의 경우 ENEPIG 적용의 필요성이 증대되는 중.

ENEPIG 공법 적용 시 팔라듐(Pd)층 도금을 위한 추가 설비 및 공정이 필요하여 공정 단가가 상승하는 단점이 있음. 그러나 HDI PCB 전체 원가 중 표면처리에 사용되는 원가의 비중은 10~20%에 불과하며, ENIG 를 ENEPIG 로 변경 시 표면처리 관련 비용이 15~30% 증가하는 수준으로, 결국 신뢰성이 높은

ENEPIG 공법을 적용한 HDI PCB 는 기존 ENIG 공법 대비 전체 원가가 약 3~6% 증가하는 수준에 그침.

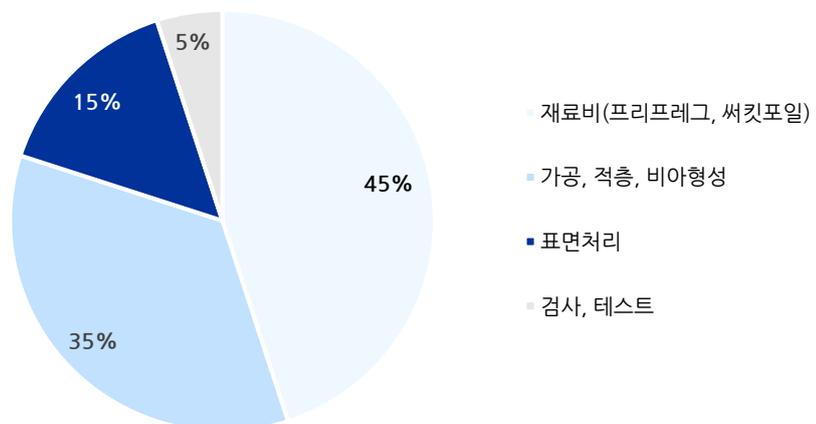
정리하면, AI 가속기 성능이 지속 고도화되는 상황 속 PCB 보드에도 고신뢰성, 고수율의 요구가 증대하고 있음. ENEPIG 적용에 따른 3~6% 수준의 PCB 생산 원가 상승분은 충분히 감내할 수 있는 수준으로 향후 ENEPIG 공법 적용이 지속 확대될 것으로 예상.

도표 5. 와이엠티 중국법인 실적 추이



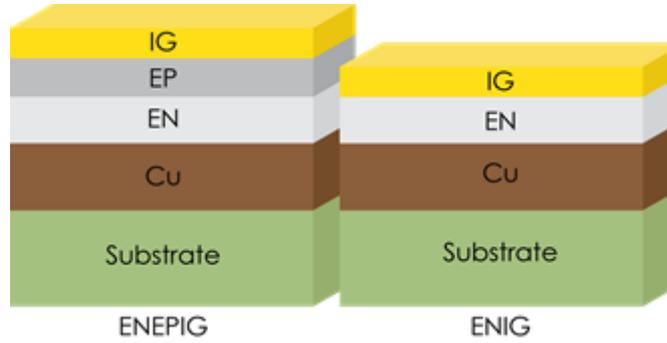
자료: 와이엠티, 유진투자증권

도표 6. HDI PCB 원가구조



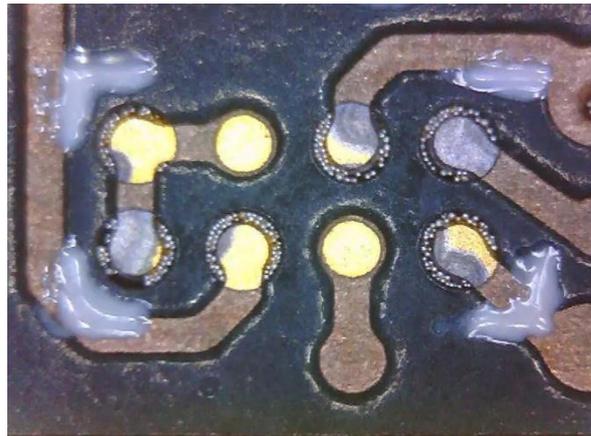
자료: 유진투자증권

도표 7. ENIG vs. ENEPIG



자료: ALLPCB, 유진투자증권

도표 8. ENIG 공법 사용시 발생하는 Black Pad



자료: GlobalWellPCBA, 유진투자증권

도표 9. 금도금 공정별 비교

구분	ENIG	ENEG	ENEPIG
구조	무전해 Ni/화학 Au	무전해 Ni/무전해 Au	무전해 Ni/무전해 Pd/화학 Au
주요 용도	일반 PCB	고신뢰성, 와이어본딩	고신뢰성, 와이어본딩, 고급 패키지
채택 패키지	BGA, CSP	일부 고신뢰 패키지	FC-BGA, SiP, 2.5D/3D
솔더링성	좋음	매우 좋음	매우 좋음
내식성	보통	우수	우수
신뢰성	보통(Black Pad 위험)	매우 우수	매우 우수(Pd 방지막 효과)
비용	낮음	높음	중간

자료: 유진투자증권

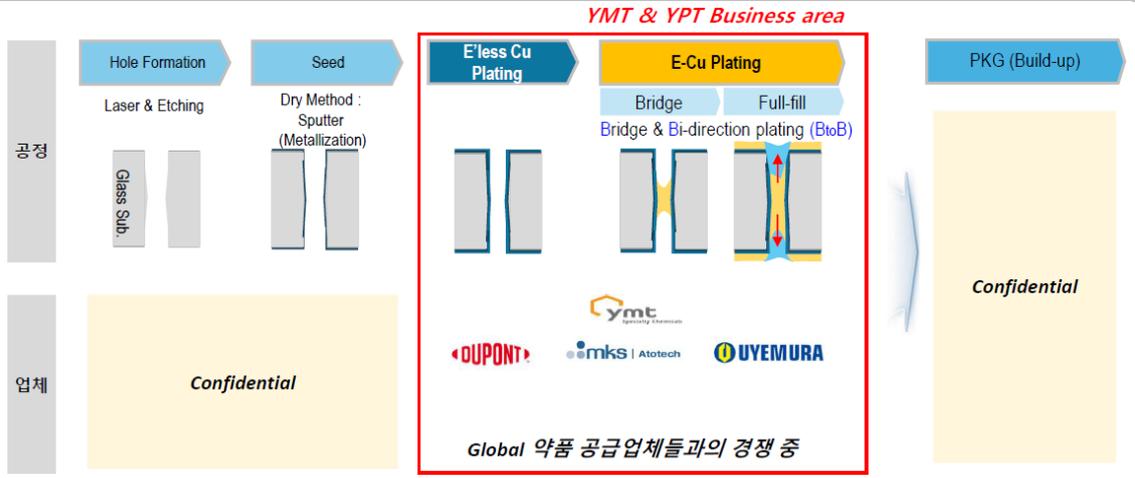
TGV Via Fill 케미컬, 도금 프로세스 내 압도적 경쟁력 확보

와이엠티는 유리 트리밍과 Hole 형성, 스퍼터링 이후 시드층 형성을 위한 무전해동도금과 Via Fill(전기동도금) 공정을 자회사 YPT 를 통해 수행하는 중. YPT 는 500mm * 500mm↑ 대면적 유리기판의 시드층 형성 및 Via Fill 공정에 대해 국내 주요 기판업체 및 IDM 향 벤더 등록을 완료한 상황. YPT 는 글라스코어, 글라스인터포저 둘 다에 대한 포트폴리오를 구축. 이 때, 와이엠티는 각각의 공정에 필요한 케미컬을 납품하며, 해당 제품에 대해 독일 아토텍, 미국 듀폰이 함께 경쟁중. 또한 자회사 YPT 가 보유하고 있는 유리기판 도금용 샘플 라인을 통해 자체적으로 케미컬~도금 프로세스의 테스트를 수행하여 경쟁 업체 대비 고객사 대응이 훨씬 빠른 상황. 향후 유상 샘플 라인 확대 및 양산 단계 진입 시 도금 약품 납품 및 도금 공정 턴키 수행에 따라 경쟁사 대비 높은 바게닝 파워를 갖게 될 것으로 예상.

유리기판 도금(시드층 형성, Via Fill) 프로세스의 주요 경쟁 요소는 ① 500mm*500mm↑ 대면적 유리원장에 대한 프로세스 수행 능력과 ② Void(Via 내부의 빈 공간)issue 의 비율, ③ 도금에 소요되는 시간의 세 측면. 와이엠티의 Via Fill 은 X-Bridge 방식으로, Bottom-up 기술 대비 Void 발생 비율은 상대적으로 높으나, Via Fill 공정에 소요되는 시간이 짧아 Bottom-up 기술 대비 높은 양산성을 확보.

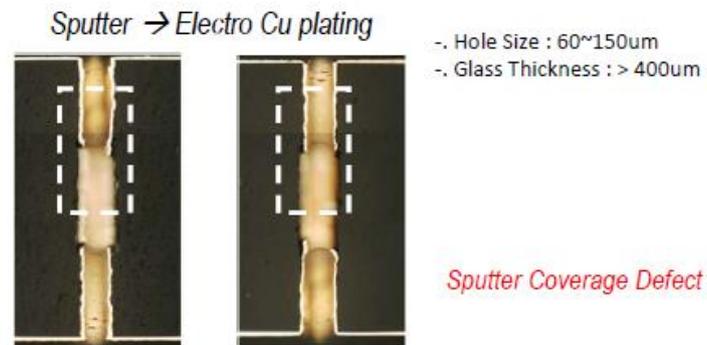
국내 대형 기판업체의 경우 유리기판 파일럿 라인의 가동을 이미 시작했으며, 오는 2027년 대량 양산을 전망. 유리기판의 엔드 유저는 대부분 서버 고객사로, 이들의 입장에서는 월 30k 수준의 생산까지도 양산이 아닌 유상 샘플 수준으로 인식. 따라서, 동사와 같이 매출과 이익 규모가 크지 않은 영세 업체의 경우, 고객사의 대량 양산 진입 이전에도 유상 샘플 공급 확대를 통해 괄목할 만한 매출 및 이익 규모 확대가 가능함.

도표 10. 와이엠티의 유리기판 밸류체인 내 사업영역

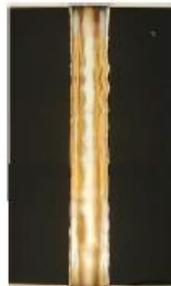


자료: 와이엠티, 유진투자증권

도표 11. TGV 내 Seed Layer 형성 관련 이슈



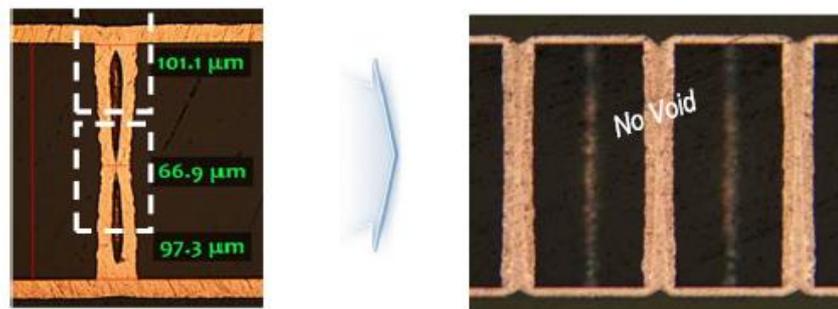
- Seed Layer 형성을 위한 Sputter 공정 한계 有 (Non-sputter 영역)
 : 전기동 미성장 영역으로 제품 불량 유발



- YMT 화학동 처리로 Defect 제거 가능
- 現 STD Process로 적용 중

자료: 와이엠티, 유진투자증권

도표 12. TGV Via Fill 공정에서의 Void 이슈



- . Hole Size : 60~150um
- . Glass Thickness : > 400um
- . Panel Size : 500*500mm

- Aspect Ratio가 클수록 PNL Size 가 클수록 Void 발생 확률 증가
- 現 Void 5% 수준에서 개발 진행 중 : 최종 Target은 No void
- 現재 경쟁사 대비 Top 수준의 기술 확보

자료: 와이엠티, 유진투자증권

T-Glass 적용 확대에 따른 제품 포트폴리오 확대 기회

일본 닛토보가 생산하는 하이엔드 유리섬유인 T-Glass 는 범용 E-Glass 소재 대비 실리카(SiO₂)와 알루미나(Al₂O₃)함량이 높아 열적 안정성과 저유전율을 특성을 가짐. 이에 따라 AI 서버 공급망을 구축하는 글로벌 팹리스 및 CSP 업체들은 고주파/고속 HDI 및 MLB 기판에 해당 T-Glass 의 사용을 확대하는 중. 그러나 높은 실리카(SiO₂)함량은 Via 내 시드층 형성을 위한 무전해동도금 시 접착력 저하와 표면 활성화의 어려움을 초래.

시드층 형성과 Via Fill 등 동도금 시장은 독일계 화학업체와 일본 J社가 독점하던 시장으로, 각각 무전해동도금과 전기동도금에 특화. 와이엠티는 이 중 무전해동도금 케미컬에 강점을 보유하고 있으며, 밸류체인 내 기존 벤더의 부진으로 국내 기판 업체와 대만계 PKG 회사가 동사의 무전해동도금 케미컬에 관심을 갖고 접촉 중. AI 및 HPC 용 IC PKG, PCB 를 제조하는 주요 업체향 T-Glass 적용 제품에 대한 동도금 케미컬 레퍼런스를 확보하는 것은 생각보다 더욱 큰 실적 모멘텀을 가져올 수 있을 것으로 예상.

도표 13. T-Glass 와 E-Glass 의 조성

성분(단위: %)	T-Glass	E-Glass
이산화규소(SiO ₂)	64~66	52~56%
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	24~26	12~16
산화칼슘(CaO)	-	20~25
산화마그네슘(MgO)	9~11	-
알칼리 산화물(R ₂ O)	-	0~0.8
산화붕소(B ₂ O ₃)	-	5~10

자료: Nittobo, 유진투자증권

도표 14. T-Glass 와 E-Glass 의 특성

특성	T-Glass	E-Glass
밀도(g/cm ³)*1	2.5	2.6
인장 강도(GPa)*2	4.8	3.2
인장 탄성 계수(GPa)	86	75
최대 신장률(%)	6.16	4.8
열팽창 계수(x10 ⁻⁶ /°C)*1	2.8	5.6
연화점(°C)*1	>1,000	844

자료: Nittobo, 유진투자증권

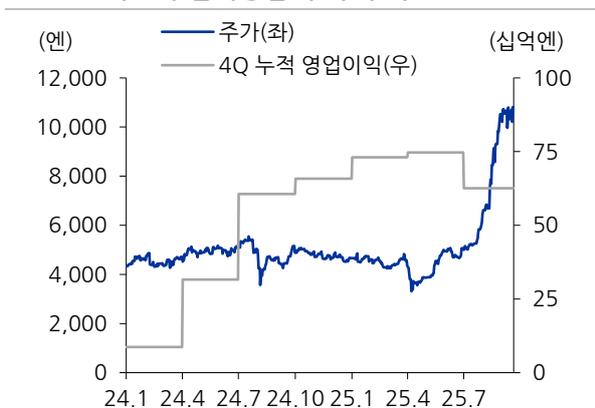
극동박(Nanotus)의 타겟 시장 확장 기회

동사의 극동박 사업은 양산 체계 구축 과정에서 2023 년 전사 차원의 영업이익 적자를 유발한 원인이었음. 최근 본사는 R&D 위주의 셋팅과 나노투스 양산 규모의 축소를 목표로 관련 인원을 50 명 이상 구조조정. 이러한 상황 속 중국계 동박 업체가 Nanotus 기술을 이용한 하이엔드 동박 시장 진출을 위해 동사에 접촉. AI GPU 밸류체인인 하이엔드 동박 시장 진입을 위해서는 9 미크론 두께의 동박 위에 1 미크론의 얇은 동박 레이어를 덧씌우고 이를 오차없이 발라내는 과정이 필요.

최근 대만 업계 소식에 따르면, 내년 출시 예정인 루빈 아키텍처 기반의 랙서버에서 HVLP4 세대 구리박이 적용될 예정이라는 소식이 있음. 극동박 시장도 AI 가속기 칩 성능의 고도화에 따라 요구 성능 수준이 점증하는 중. 동사에 접촉중인 중국계 동박 업체가 Nanotus 기술을 이용해 하이엔드 동박 시장에 진출하게 될 경우 판매금액에 대한 로열티와 일부 시장에 대한 판권을 가져오는 식의 계약이 이루어질 수 있을 것으로 예상.

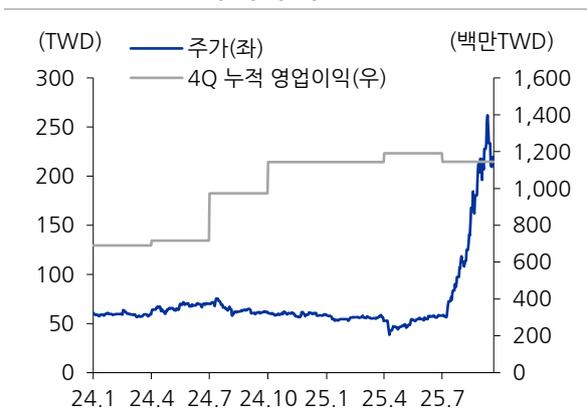
한편, 루빈 아키텍처에서의 구리박 스펙 상향은 구리박 제조 업체에게 30%의 캐파 손실과 약 40% 수준의 가격 상승 효과를 동반할 것으로 예상됨. 이에 주요 구리박 제조업체인 미쓰이 금속광업과 Co-Tech 은 이러한 변화를 선반영하여 주가 급등세를 보이는 중.

도표 15. 미쓰이 금속광업 주가 추이



자료: 유진투자증권

도표 16. Co-Tech 주가 추이

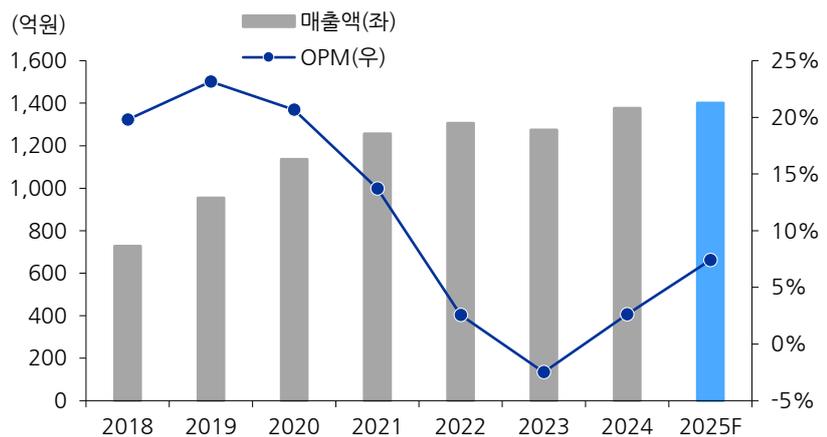


자료: 유진투자증권

Ⅲ. 실적 전망 및 결론

2025년 연간 실적은 매출액 1,401억원(YoY +1.8%), 영업이익 104억원(YoY +189%, OPM 7.4%)예상. 기존 FPCB와 PKG 시장 위주의 대응에서 VGT로의 레퍼런스 확보를 통해 HDI/MLB/FC-BGA 기판 시장으로 대응 영역을 확장하는 초입. 2분기 중국 법인을 통해 매출 인식이 시작된 AI PCB 향 금도금 케미컬의 경우, 초도 물량에 해당하는 수준의 매출 인식이 진행중이며 아주 빠른 속도의 매출액 확대 가능성은 가늠하기 어려우나 HDI PCB 시장 내 금도금 케미컬의 TAM을 고려시 동사의 기술적 경쟁우위가 빠른 시일 내 실적으로 확인될 것으로 예상. 최근 5영업일간 동사 주가상승률은 54%로 다소 가파르게 올랐으나, ①AI PCB 향 레퍼런스에 기반한 금도금 케미컬 사업의 확장성, ②전방 고객사의 유리기판 샘플 라인 확대 및 양산 진입 시 높은 실적 개선 가능성, ③T-Glass 적용 확대에 따른 제품 포트폴리오 확대 기회, ④중국계 동박 업체와의 협업을 통한 하이엔드 동박 시장 진출 등 다양한 모멘텀 및 가능성을 고려한다면 중장기적으로 꾸준한 실적 개선과 괄목할 만한 추가 퍼포먼스를 보여줄 수 있을 것으로 기대.

도표 17. 와이엠티 연간 실적 추이



자료: 와이엠티, 유진투자증권

와이엠티(251370.KQ) 재무제표

대차대조표

(단위:십억원)	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A
자산총계	198	246	248	250	351
유동자산	107	137	114	91	115
현금성자산	60	80	66	42	58
매출채권	28	27	23	27	28
재고자산	15	19	19	14	17
비유동자산	92	110	134	159	235
투자자산	13	13	22	30	16
유형자산	77	96	110	127	218
기타	2	2	2	2	1
부채총계	80	107	97	102	154
유동부채	45	79	79	81	79
매입채무	9	13	11	14	18
유동성이자부채	34	63	66	65	58
기타	1	2	2	2	3
비유동부채	35	28	18	21	75
비유동이자부채	29	19	9	13	62
기타	6	9	9	8	13
자본총계	118	139	151	148	197
지배지분	99	113	125	123	172
자본금	7	7	8	8	8
자본잉여금	25	25	36	35	36
이익잉여금	67	77	76	74	69
기타	(1)	4	5	6	58
비지배지분	19	26	26	25	25
자본총계	118	139	151	148	197
총차입금	64	82	74	78	120
순차입금	4	3	8	36	62

현금흐름표

(단위:십억원)	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A
영업현금	24	22	13	8	7
당기순이익	20	14	3	(0)	(2)
자산상각비	6	7	8	9	9
기타비현금성손익	6	9	7	2	9
운전자본증감	(3)	(4)	3	4	(3)
매출채권감소(증가)	(17)	(6)	21	(4)	1
재고자산감소(증가)	(2)	(3)	(0)	5	(2)
매입채무증가(감소)	19	9	(21)	2	(1)
기타	(2)	(4)	2	1	(1)
투자현금	(25)	(26)	(31)	(26)	(40)
단기투자자산감소	(3)	(3)	0	6	(3)
장기투자증권감소	1	0	1	0	0
설비투자	(21)	(23)	(24)	(28)	(37)
유형자산처분	(0)	0	1	1	1
무형자산처분	(1)	(0)	(0)	(0)	0
재무현금	17	14	1	5	32
차입금증가	14	12	1	6	36
자본증가	2	1	0	0	(3)
배당금지급	0	0	0	0	0
현금 증감	14	15	(17)	(14)	1
기초현금	42	56	70	53	40
기말현금	56	70	53	40	40
Gross Cash flow	32	29	18	10	16
Gross Investment	25	27	28	27	40
Free Cash Flow	6	3	(10)	(17)	(23)

자료: 유진투자증권

손익계산서

(단위:십억원)	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A
매출액	114	126	131	127	137
증가율(%)	(13)	11	4	(2)	8
매출원가	74	89	99	106	111
매출총이익	39	37	31	22	27
판매 및 일반관리비	16	19	28	25	23
기타영업손익	0	0	0	0	0
영업이익	23	17	3	(3)	4
증가율(%)	604	(27)	(81)	적전	흑전
EBITDA	29	24	11	5	13
증가율(%)	162	(18)	(53)	(51)	137
영업외손익	(2)	(1)	0	3	(4)
이자수익	1	1	1	2	2
이자비용	2	2	3	4	5
지분법손익	0	0	0	0	0
기타영업외손익	(0)	1	1	5	(2)
세전순이익	22	16	3	(0)	(1)
증가율(%)	538	(25)	(79)	적전	적지
법인세비용	2	2	1	(0)	1
당기순이익	20	14	3	(0)	(2)
증가율(%)	661	(29)	(82)	적전	적지
지배주주지분	14	10	(0)	(3)	(4)
증가율(%)	흑전	(31)	적전	적지	적지
비지배지분	6	4	3	3	2
EPS(원)	456	311	(2)	(91)	(140)
증가율(%)	흑전	(32)	적전	적지	적지
수정EPS(원)	456	311	(2)	(91)	(140)
증가율(%)	흑전	(32)	적전	적지	적지

주요투자지표

	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A
주당지표(원)					
EPS	456	311	(2)	(91)	(140)
BPS	3,215	3,625	3,946	3,879	5,543
DPS	0	75	0	0	0
밸류에이션(배, %)					
PER	43.7	72.8	n/a	n/a	n/a
PBR	6.2	6.2	3.5	3.6	2.5
EV/ EBITDA	10.2	14.2	0.7	6.6	4.8
배당수익률	0.0	0.3	n/a	n/a	n/a
PCR	19.5	23.9	24.6	42.2	26.0
수익성(%)					
영업이익률	20.7	13.7	2.6	(2.5)	2.6
EBITDA이익률	26.0	19.2	8.6	4.3	9.4
순이익률	17.4	11.2	2.0	(0.1)	(1.7)
ROE	15.9	9.1	(0.0)	(2.3)	(2.9)
ROIC	19.5	11.3	1.7	(1.4)	1.2
안정성 (배, %)					
순차입금/자기자본	3.0	2.1	5.3	24.2	31.4
유동비율	236.6	173.3	144.3	112.4	145.1
이자보상배율	12.6	7.6	1.3	(0.8)	0.8
활동성 (회)					
총자산회전율	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
매출채권회전율	4.1	4.6	5.2	5.1	5.0
재고자산회전율	7.9	7.3	6.9	7.7	8.7
매입채무회전율	12.9	11.2	10.6	9.9	8.5

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다
 당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다
 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
 조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다
 동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다
 동 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다
 동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다
 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함) 당사 투자의견 비율(%)

· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	0%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	98%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	2%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2025.06.30 기준)